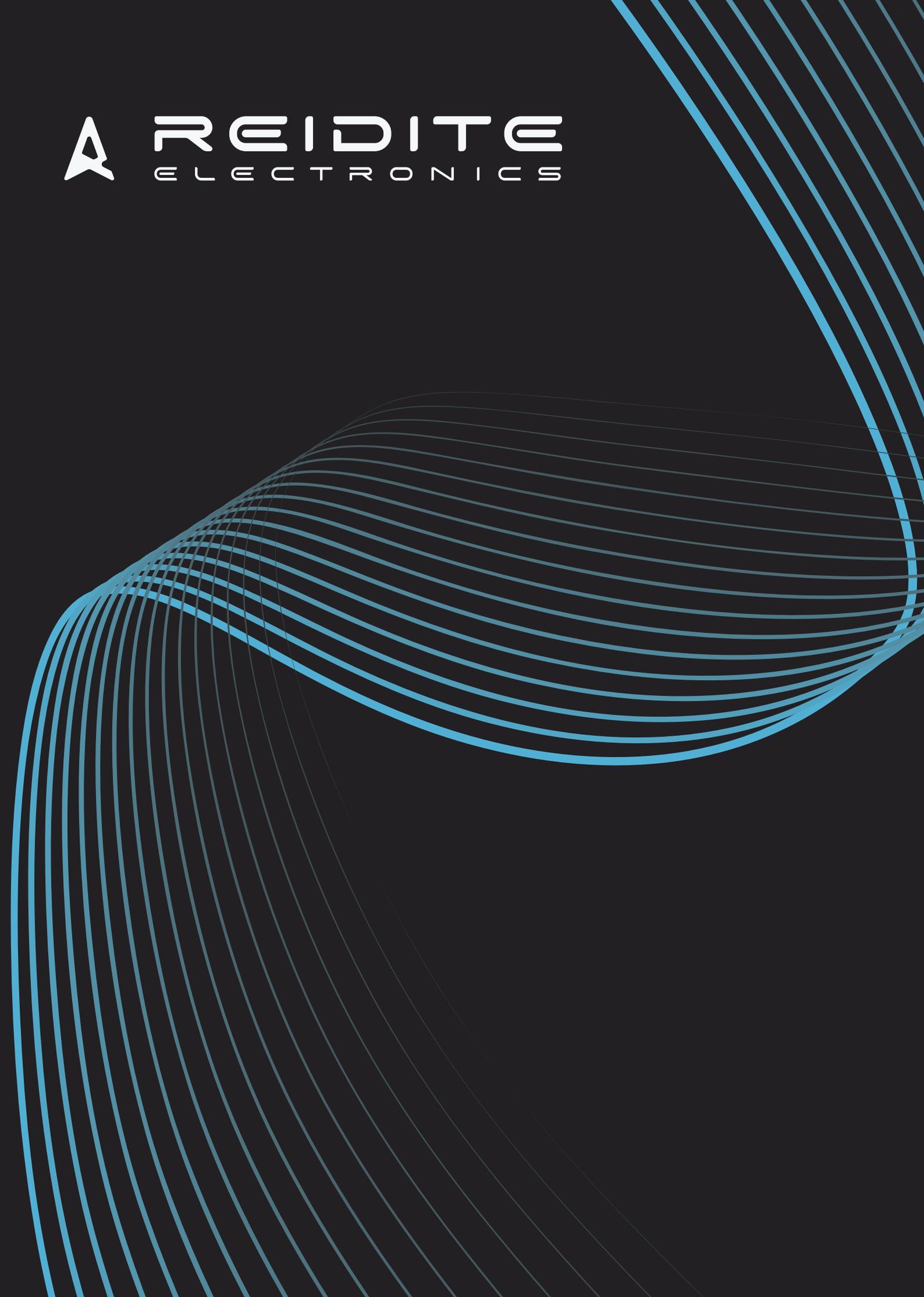




REIDITE
ELECTRONICS



ÍNDICE

- 01. Resumen de la empresa**
- 02. Posición competitiva y Mercado**
- 03. Sector, competencia y clientes**
- 04. Equipo humano y organigrama**
- 05. Crecimiento económico y escalabilidad del negocio**
- 06. Producto**
- 07. Objetivos**
- 08. Grado de innovación y reto tecnológico**

RESUMEN DE EMPRESA

REIDITE Electronics es una empresa de ingeniería fundada a principios de 2024 en Madrid, España. Nace con la visión de liderar el espacio europeo de microelectrónica y electrónica a corto plazo, y a largo plazo dar el salto hacia la arquitectura RISC-V

A circular microchip die with a colorful, multi-layered pattern of yellow, orange, and purple, showing a grid-like structure.

A corto plazo pretendemos **diseñar, desarrollar y fabricar nuestro propio hardware basado en Microcontroladores y FPGAs e Incluir un software de sistema básico que hace nuestro hardware plug and play.**

A largo plazo, pretendemos **diseñar e integrar nuestros propios chips** (Integrated Circuit) basados en la arquitectura de computadores RISC-V. Además, pretendemos crear nuestro propio entorno de desarrollo integrado (IDE) que permite el desarrollo de software de nuestros clientes en una plataforma centralizada.

A circular microchip die with a blue and white grid pattern, showing a grid-like structure.

TECNOLOGÍA

En REIDITE Electronics SL diseñamos y fabricamos **módulos electrónicos estandarizados** que se utilizan para el control de sistemas físicos, **sistemas de alto rendimiento orientados a sistemas críticos y no críticos**. Pretendemos ofrecer productos robustos, siguiendo los más altos estándares existentes en las industrias tecnológicas, así como cumplir con los requisitos más exigentes y estrictos a través de certificar, validar y homologar nuestros productos.

Estos **módulos electrónicos estandarizados** se denominan **System On Modules** (SoM) son tarjetas electrónicas de pequeño tamaño, en concreto **Compute Module**, de 55x40 mm o formato **M.2**, de 22x60mm y un grosor de apenas 4mm. Estos módulos son objeto de un innovador proceso de encapsulamiento, desarrollado y pendiente de patente por nuestra parte, que mejora sus características físicas. Este procedimiento no solo aumenta la resistencia del dispositivo, sino que también potencia sus capacidades operativas



EQUIPO

Chief Executive Officer (CEO)
Co-Founder
Carlos Vaello Martínez



Chief Technology Officer (CTO)
Co-Founder
Manuel Luis Alcazar Laynez

Manager Director (MD)
Main Manager
Julieta Gerbaudo Delfino

Hardware Manager
Hardware
Estefanía Llano Perez

Software Manager
Software
Carlos Cotano Barroso

Fabricación Manager
Fabricación
Jorge de la Fuente Muelas



Chief Technology Officer (CTO)
Co-Founder
Manuel Luis Alcazar Laynez

Chief Executive Officer (CEO)
Co-Founder
Cesar David Vera Moreno

PRODUCTOS

XIPHOS
MPU + uFPGA

2025



ZENITH
FPGA + ARM Cores

2026



NEXAR
FPGA + RISC-V Softcores

2027



ATLAS
FPGA + RISC-V Cores

2028

